

開催日 : 11月19日(火), 20日(水)
 開催場所 : 千里ライフサイエンスセンター(大阪)

第1日目			
時間			講義内容
9:30-12:30	セクション1	藤本 公三 (大阪大学)	第1章 エレクトロニクス実装技術におけるマイクロソルダリング
			第2章 設計技術の基礎
			第3章 マイクロソルダリングの基礎知識
12:30-13:30			《 昼食休憩 》
13:30-16:50	セクション2	鎌田 信雄 (化研テック)	第4章 実装材料
			第5章 プリント配線板, 電子部品の種類と特徴
			第6章 電子部品実装プロセス
第2日目			
時間			講義内容
9:15-12:15	セクション3	齊藤 進 (元 パナソニック)	第7章 プリント配線板の設計
			第8章 実装ライン設計と実装工程管理
			第9章 ソルダリング不良と防止策
12:30-13:30			《 昼食休憩 》
13:15-16:15	セクション4	藤本 公三 (大阪大学)	第10章 ソルダリングによる接合部の品質, 信頼
			第11章 ソルダリングによる接合部の試験・検査
			第12章 安全・衛生・環境などに関する知識
16:15-16:20			《 休憩 》
16:20-17:00			修了レポート作成提出

開催日 : 12月10日(火), 11日(水)
 開催場所 : (社)日本溶接協会 (東京 秋葉原)

第1日目			
時間			講義内容
9:30-12:30	セクション1	藤本 公三 (大阪大学)	第1章 エレクトロニクス実装技術におけるマイクロソルダリング
			第2章 設計技術の基礎
			第3章 マイクロソルダリングの基礎知識
12:30-13:30			《 昼食休憩 》
13:30-16:50	セクション2	加藤 正幸 (東芝)	第4章 実装材料
			第5章 プリント配線板, 電子部品の種類と特徴
			第6章 電子部品実装プロセス
第2日目			
時間			講義内容
9:15-12:15	セクション3	河野 英一 (河野エムイー研究所)	第7章 プリント配線板の設計
			第8章 実装ライン設計と実装工程管理
			第9章 ソルダリング不良と防止策
12:30-13:30			《 昼食休憩 》
13:15-16:15	セクション4	佐藤 武彦 (大阪大学)	第10章 ソルダリングによる接合部の品質, 信頼
			第11章 ソルダリングによる接合部の試験・検査
			第12章 安全・衛生・環境などに関する知識
16:15-16:20			《 休憩 》
16:20-17:00			修了レポート作成提出